

Intel Lunar Lake в стадии массового производства TSMC на узле N3B, первые ноутбуки ожидаются в 3 квартале 2024 года

Согласно отчету тайваньского отраслевого обозревателя DigiTimes, TSMC начала массовое производство чипов для Intel на своем 3-нм литейном узле EUV FinFET. Intel использует 3-нм узел TSMC для вычислительной части своего будущего процессора Core Ultra 300 «Lunar Lake».

Компания подробно рассказала о «Lunar Lake» в своей презентации Computex 2024. В то время как дезагрегированный процессор на основе чиплетов, такой как «Meteor Lake», новый чип «Lunar Lake» предполагает, что ядра ЦП, iGPU, NPU и контроллеры памяти расположены на одном чиплете, называемом вычислительным блоком, построенном на узле 3 нм; в то время как компоненты SoC и ввода-вывода разделены, единственный другой чипсет чипа — плитка SoC, построенная на узле TSMC 6 нм.

Intel не вдавалась в подробности «Arrow Lake», за исключением упоминания, что процессор будет иметь те же P-ядра «Lion Cove» и E-ядра «Skymont», что и «Lunar Lake», хотя и расположены в более удобном порядке, знакомая конфигурация кольцевой шины, в которой кластеры E-core используют кеш-память L3 совместно с P-ядрами (чего не происходит в «Lunar Lake»). «Arrow Lake» также оснащен iGPU, основанным на той же графической архитектуре Xe2, что и «Lunar Lake», и будет оснащен NPU, соответствующим требованиям Microsoft Copilot+ AI PC.

Что остается загадкой в «Arrow Lake», так это то, как Intel собирается организовывать различные чиплеты или плитки. В отчетах за февраль 2024 года упоминалось, что Intel использует 3-нм техпроцесс TSMC только для дезагрегированной графической плитки «Arrow Lake», но теперь мы знаем из «Lunar Lake», что Intel не уклоняется от того, чтобы позволить TSMC производить ядра своих процессоров.

Ожидается, что первые ноутбуки на базе Lunar Lake появятся на прилавках в третьем квартале 2024 года, а Arrow Lake появится на прилавках в четвертом квартале.